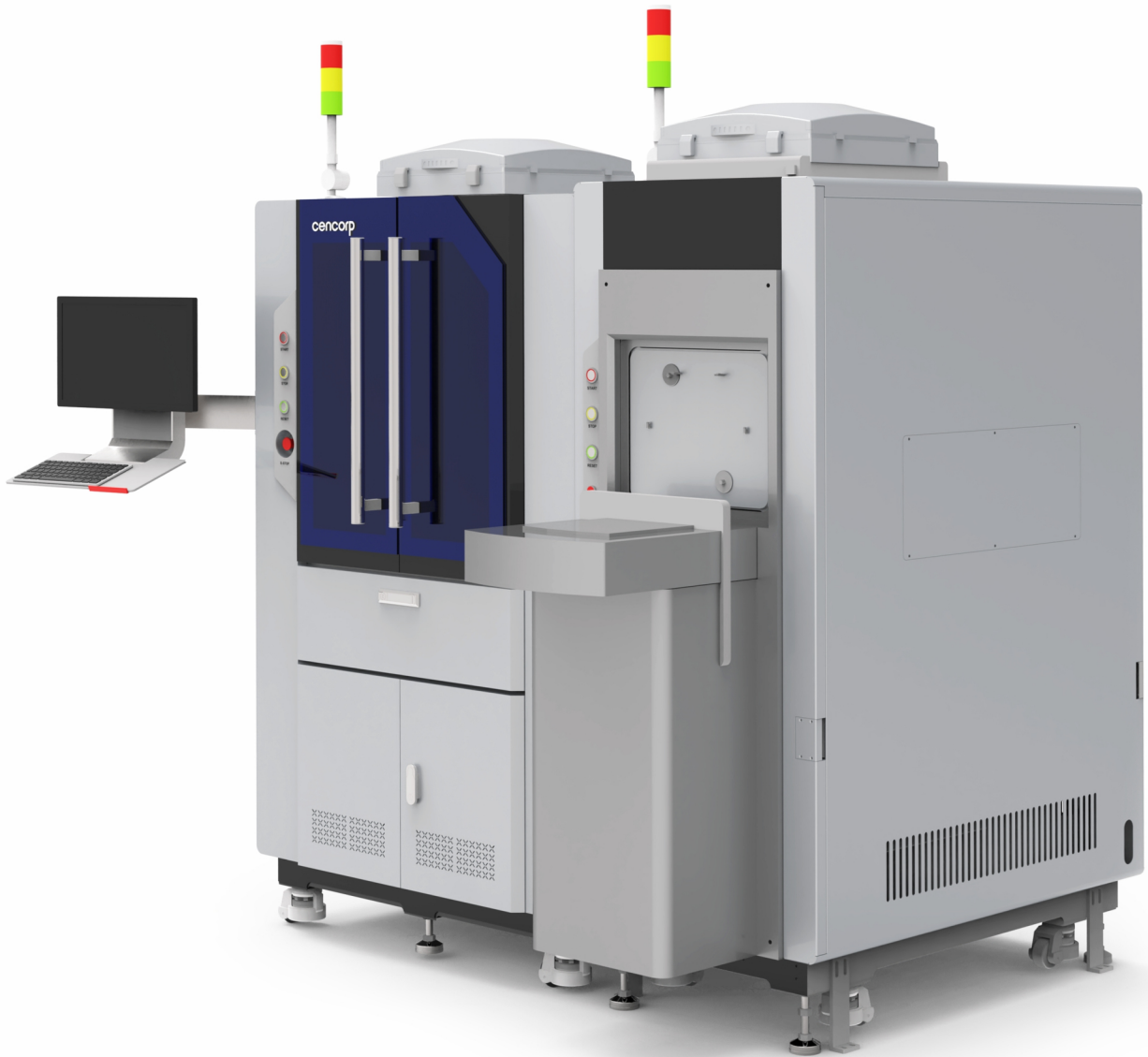


3600 WS

半导体系列

晶圆分选设备

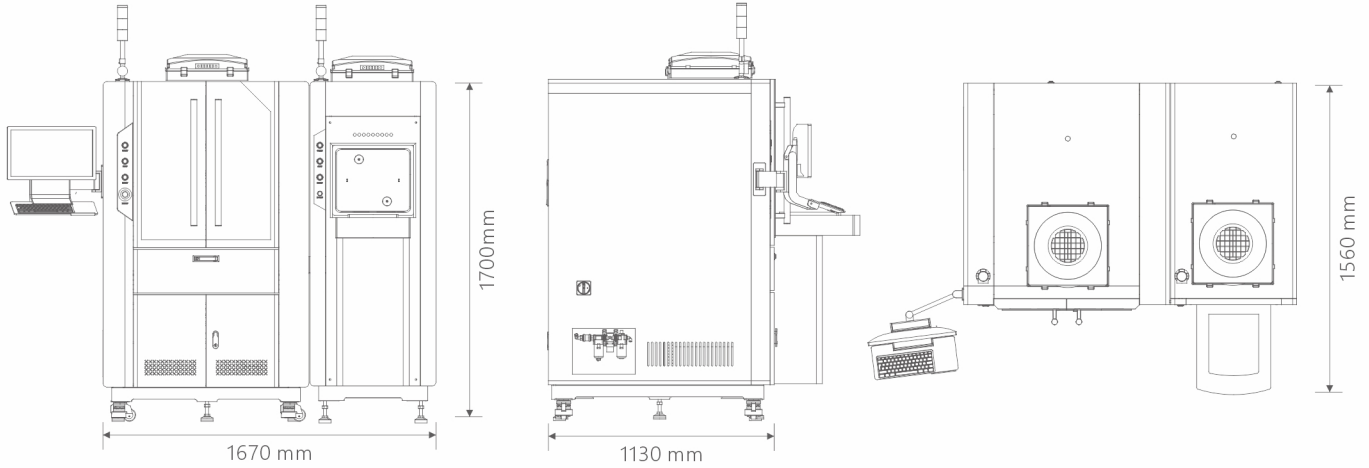


Cencorp 3600 WS配备自动晶圆机械手和自主研发晶圆对准器以及前开式晶圆传送盒(FOUP),使其可同时处理8寸和12寸晶圆。

选用具备主动调平功能的高精度运动平台
可实现晶圆翘曲自动校正
主动力反馈控制功能使晶圆在夹取过程中最小化变形
自主研发的软件平台可实时监控设备状态
满足0级静电防护(ESD)标准和1000级洁净室标准

3600 WS

技术参数



设备基本参数

宽度: 1670mm
深度: 1130mm
高度: 1700mm
重量: 1840kg

设备精度

轴重复精度 (x, y, z): ± 0.003 mm
系统精度: ± 0.005 mm

芯片处理能力

晶圆尺寸: 12 英寸 (8 英寸可选)

基础功能

安全互锁门
可调节抓取头
平均无故障间隔时间: 168小时
平均辅助间隔时间: 4小时
平均修复时间: 15分钟
平均辅助时间: 3分钟
静电防护等级: 0级
噪音: <75dB

用户界面

运行系统: Windows
网络连接: 可选

视觉系统

多种视觉工具
基准点识别时间: <1s
产品ID识别
视觉飞拍功能

可选功能

条码类型: 1D or 2D
寻边切割及切割检测
绝对精度校准
支持MES追溯系统
本地数据管理系统
离线编程
SECS/GEM 部署对接

电气要求

电压: 交流 220/110V
频率: 50/60Hz
最大功率: 4KW

气源要求

气压: 5-7 bar
预计消耗气量: 100 L/min

环境要求

工作温度: 10-40°C
工作湿度: 30%-85%